

Fill-Pad US600导热垫片

| 产品描述



导热垫片Fill-Pad US600具有超软，低压力下高形变特性，其导热系数为6.0W/m-K。适用于需要多形变公差的应用，是一款非常杰出的导热材料，在填充不同尺寸的间隙的同时，产生非常微弱甚至可以忽略的回弹应力，最大程度地减小对精密电子器件的冲击。独特的配方设计使其有良好的界面润湿性，导热性及优秀的力学特性，可适用于多种应用环境，不会因为压力和温度的波动而失效。该款导热垫片具有自粘性，无需背胶。对于一些特殊的使用需要，也可以单面涂覆涂层，制成单面不粘的产品，便于操作。

| 产品特点

- ◆ 导热系数6.0W/m-K
- ◆ 双面自粘性或者单面粘性可选择
- ◆ 良好的表面润湿性可以充分降低接触热阻
- ◆ 较低压力产生较高形变量，弥补设计公差
- ◆ 高柔顺性

| 典型应用

- ◆ 汽车电子及动力电池
- ◆ 硬盘驱动器及固态硬盘存储设备
- ◆ 通信基站、无线基础设施、光模块
- ◆ LCD、PDP和激光电视显示器
- ◆ 工业、LED照明及电源模块
- ◆ 发热元器件与散热器或壳体之间散热

| 技术参数

性能参数	Fill-Pad US600	测试方法
基本特性		
结构	陶瓷粉填充硅胶片	N/A
颜色	深灰色	目视
厚度范围 (mm)	0.50 ~ 5.00	N/A
密度 (g/cm ³)	3.4	ASTM D792
硬度(Shore 00)	40	ASTM D2240
挥发物 TML (%)	0.37	ASTM E595
挥发物 CVCN (%)	0.07	ASTM E595
ΣD3-D10(硅氧烷含量PPM)	<100	GC-MS
工作温度(°C)	-40 ~150	泰吉诺实验室
导热性能		
导热系数 (W/m-K)	6.0	ASTM D5470
热阻 (°C·in ² /W) (1mm@10psi)	0.20	ASTM D5470
电学性能		
介电常数@ 1 MHz	8.1	ASTM D150
体积电阻率(ohm-cm)	3.0X10 ¹⁵	ASTM D257
阻燃等级		
阻燃等级	V-0	UL 94

注：本资料中数据皆为测试典型值，结果仅供参考，不可作为产品性能指标使用

| 注意事项

- ◆ 切勿食用
- ◆ 避开儿童可触及的地方保管
- ◆ 产品放置须远离火源
- ◆ 请确认使用的正确性之后再使用
- ◆ 注意不要让产品表面沾上异物和灰尘

| 保存及寿命

- ◆ 产品需在0-35°C，≤65%相对湿度环境下保存
- ◆ 保质期自包装日起12个月

| 订购信息

- ◆ 厚度标称值±10% (≥1mm)；标称值±0.1mm (<1mm)，厚度可以根据客户要求定制。订购前请详询可用厚度

